

**平成22年3月期
(第8期)
第2四半期決算説明会**

**平成21年11月5日
株式会社ジーダット**

上期実績と通期見通しのポイント

上期は計画比売上高 $\Delta 12\%$ 、経常利益 $\Delta 79\%$

通期は計画比売上高 $\Delta 11\%$ 、経常利益 $\Delta 77\%$

研究開発投資は、ほぼ計画通り継続

新製品開発・リリースは、ほぼ計画通り

更なる固定費圧縮により、経常利益黒字を確保

上期実績 - 前年同期比・計画比 -

(単位:百万円)

	平成21年3月期	平成22年3月期			
	実績	当初計画	実績	前年同期比	当初計画比
売上高	1,234	790	694	△44%	△12%
売上総利益	909	539	464	△49%	△14%
販売費及び 一般管理費	613	538	515	△16%	△4%
営業利益	295	1	△51		
経常利益	322	32	6	△98%	△79%
特別損失	—	—	14	固定資産除却損 事業所移転費用	
当期純利益	215	20	△4		

通期見通し -前年同期比・計画比-

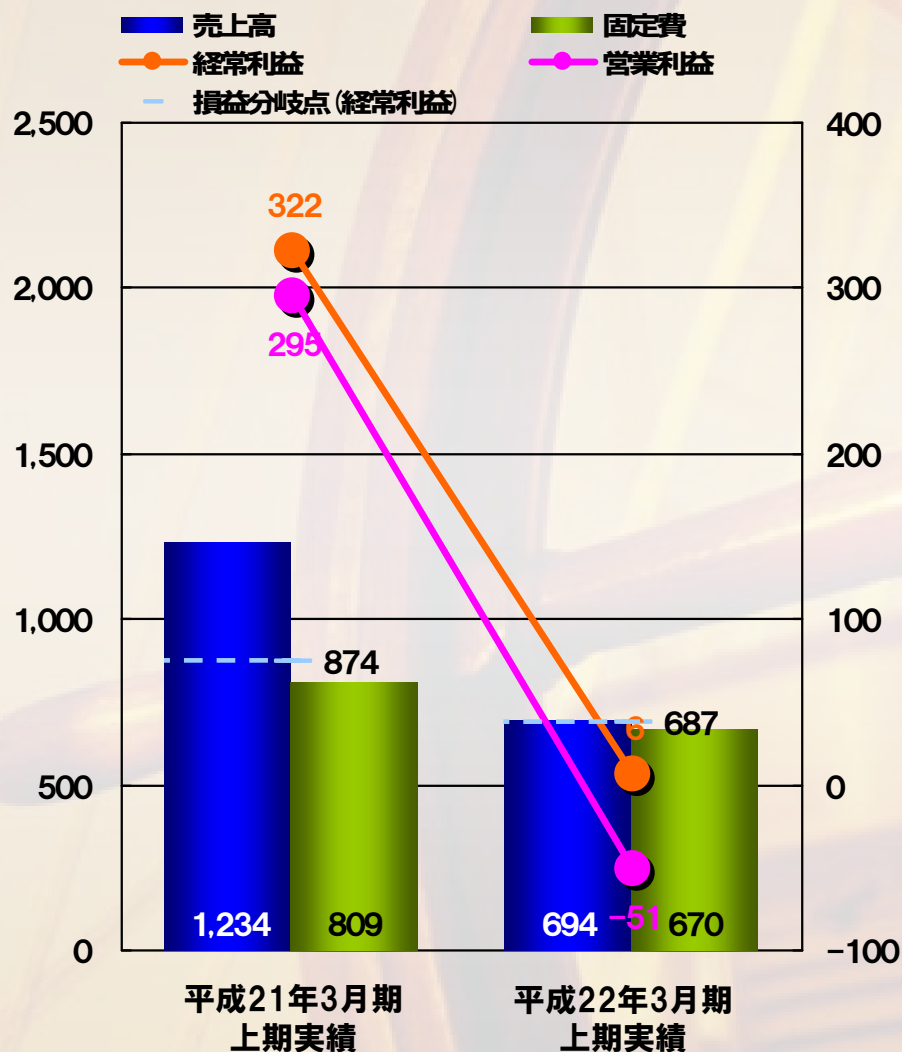
(単位:百万円)

	平成21年3月期	平成22年3月期			
	実績	当初計画	見通し	前年同期比	当初計画比
売上高	2,074	1,630	1,450	△30%	△11%
売上総利益	1,474	1,119	966	△34%	△14%
販売費及び 一般管理費	1,247	1,117	1,066	△14%	△5%
営業利益	227	2	△100		
経常利益	264	85	20	△92%	△77%
特別損失	—	—	14		
当期純利益	58	50	0		

売上高・利益 - 前年同期比 -

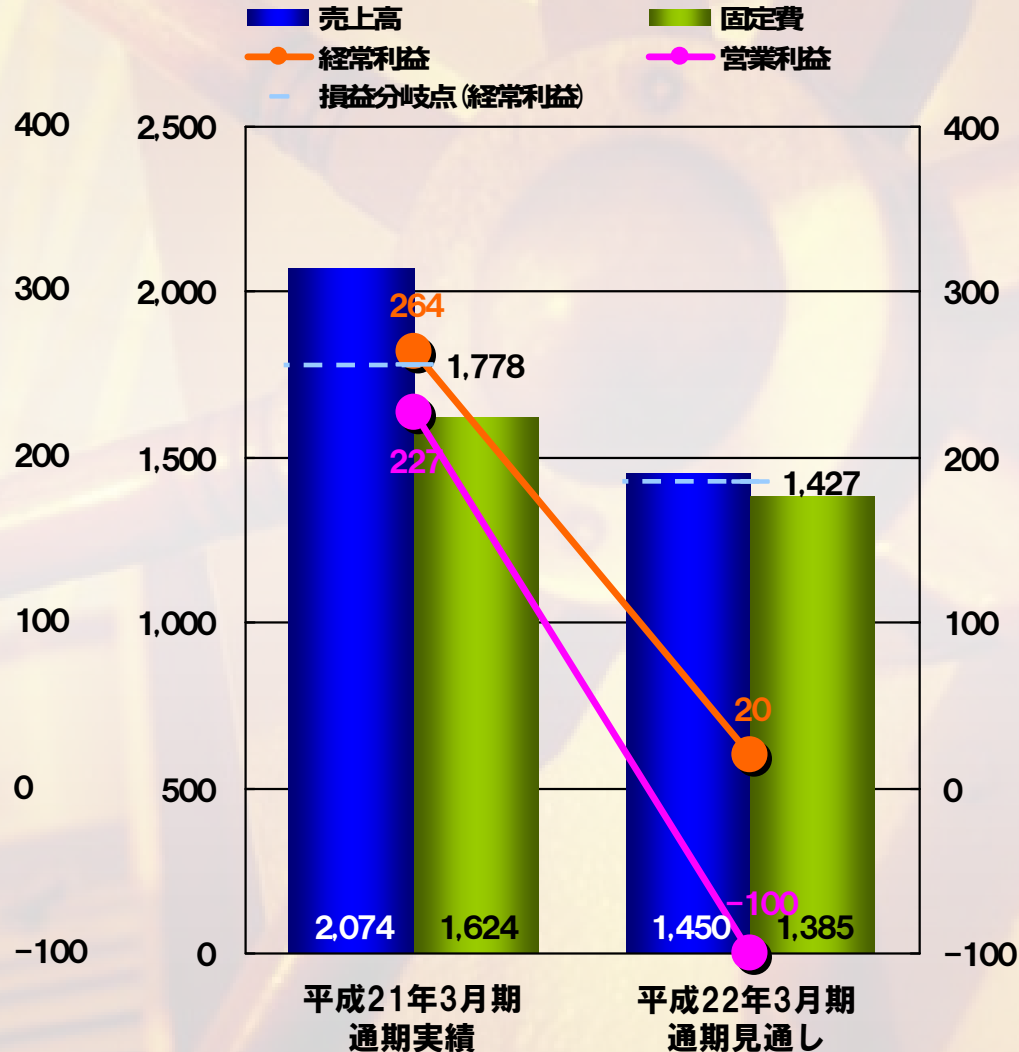
【半期比】

(単位:百万円)



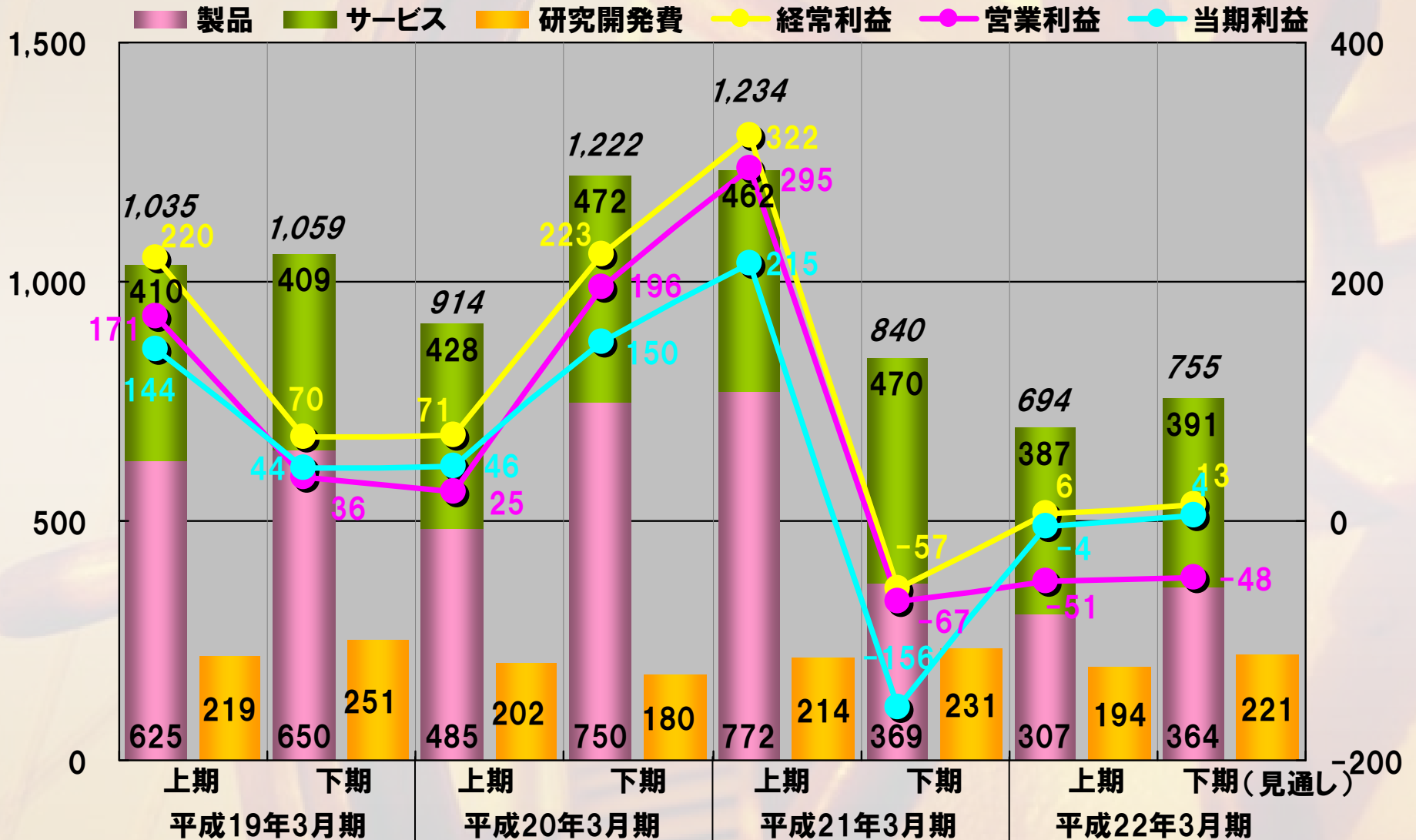
【通期比】

(単位:百万円)



半期毎売上高・利益の推移

(単位：百万円)



連結貸借対照表 - 前期比 -

(単位:百万円)

	平成21年 3月31日	平成21年 9月30日	差異		平成21年 3月31日	平成21年 9月30日	差異
(資産の部)				(負債の部)			
I 流動資産	1,474	1,466	△7	I 流動負債	379	410	31
1 現金及び預金	1,070	1,132	61	1 買掛金	63	50	△12
2 受取手形及び売掛金	298	240	△57	2 未払法人税等	28	5	△23
3 たな卸資産	13	17	4	3 賞与引当金	80	50	△29
4 繰延税金資産	39	23	△16	4 前受金	-	247	247
5 その他	54	55	0	5 その他	206	55	△150
6 貸倒引当金	△3	△2	0	負債合計	379	410	31
II 固定資産	1,352	1,350	△2	(純資産の部)			
1 有形固定資産	21	32	11	I 株主資本	2,449	2,406	△42
2 無形固定資産	40	35	△4	1 資本金	760	760	-
3 投資その他の資産合計	1,291	1,282	△8	2 資本剰余金	890	890	-
(1) 長期貸付金	3	2	△1	3 利益剰余金	831	788	△42
(2) 繰延税金資産	207	229	22	4 自己株式	△32	△32	-
(3) 長期預金	1,000	1,000	-	II 評価・換算差額等	△1	0	2
(4) その他	80	50	△29	為替換算調整勘定	△1	0	2
				純資産合計	2,447	2,407	△40
				負債純資産合計	2,826	2,817	△9
資産合計	2,826	2,817	△9				

敷金回収・差入れ差額

前受金増大に伴う掲記変更

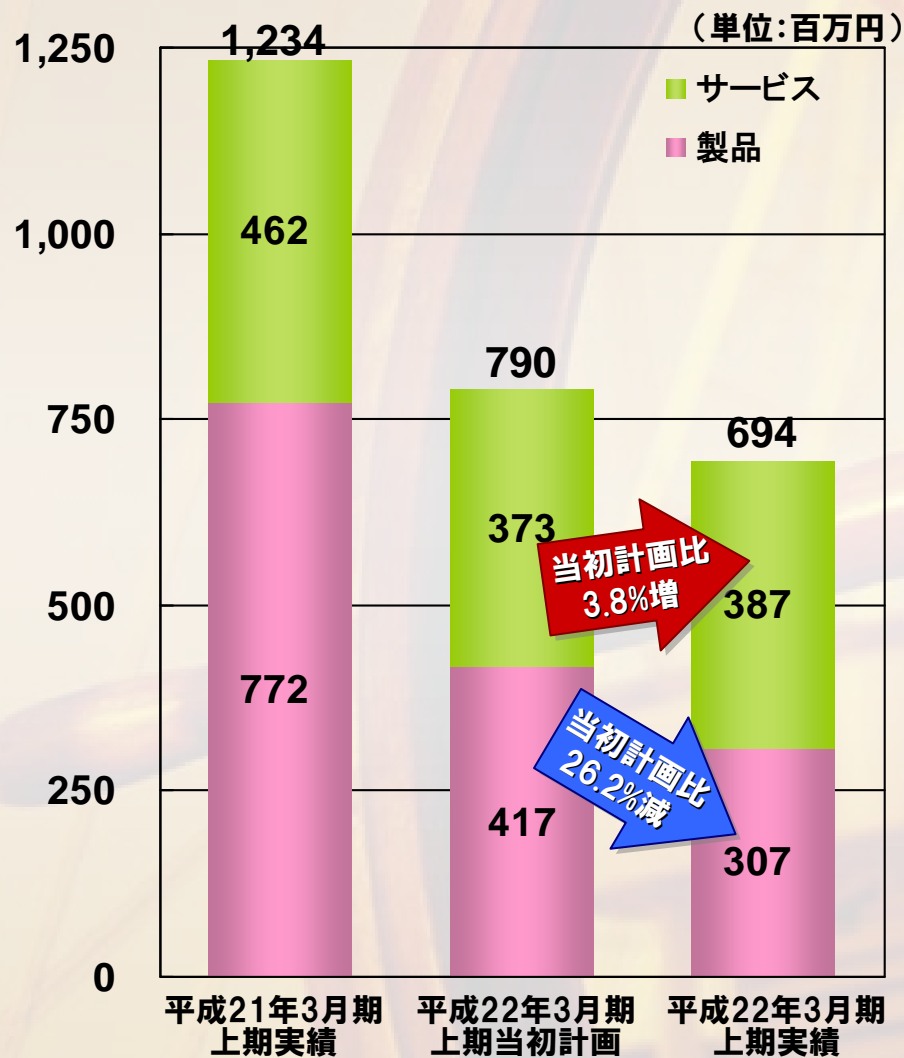
連結キャッシュフロー計算書 - 前年同期比 -

(単位:百万円)

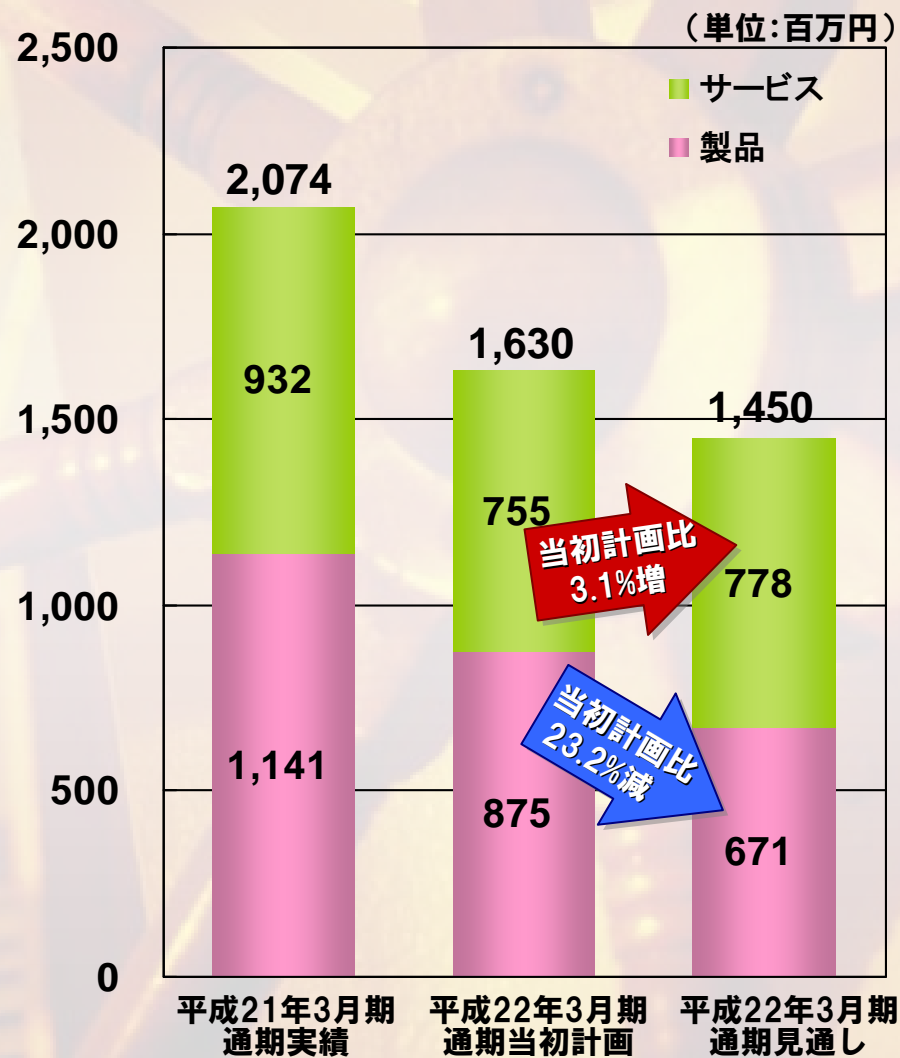
	平成20年4月1日 ～ 平成20年9月30日	平成21年4月1日 ～ 平成21年9月30日	差異
I 営業活動によるキャッシュ・フロー	408	86	△321
II 投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 348	11	359
III 財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 38	△38	—
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	△0	2	2
V 現金及び現金同等物の増減額 (減少:△)	20	61	40
VI 現金及び現金同等物の期首残高	1,348	1,070	△277
VII 現金及び現金同等物の期末残高	1,368	1,132	△236

事業別売上高（製品／サービス） -対計画比-

【半期比】

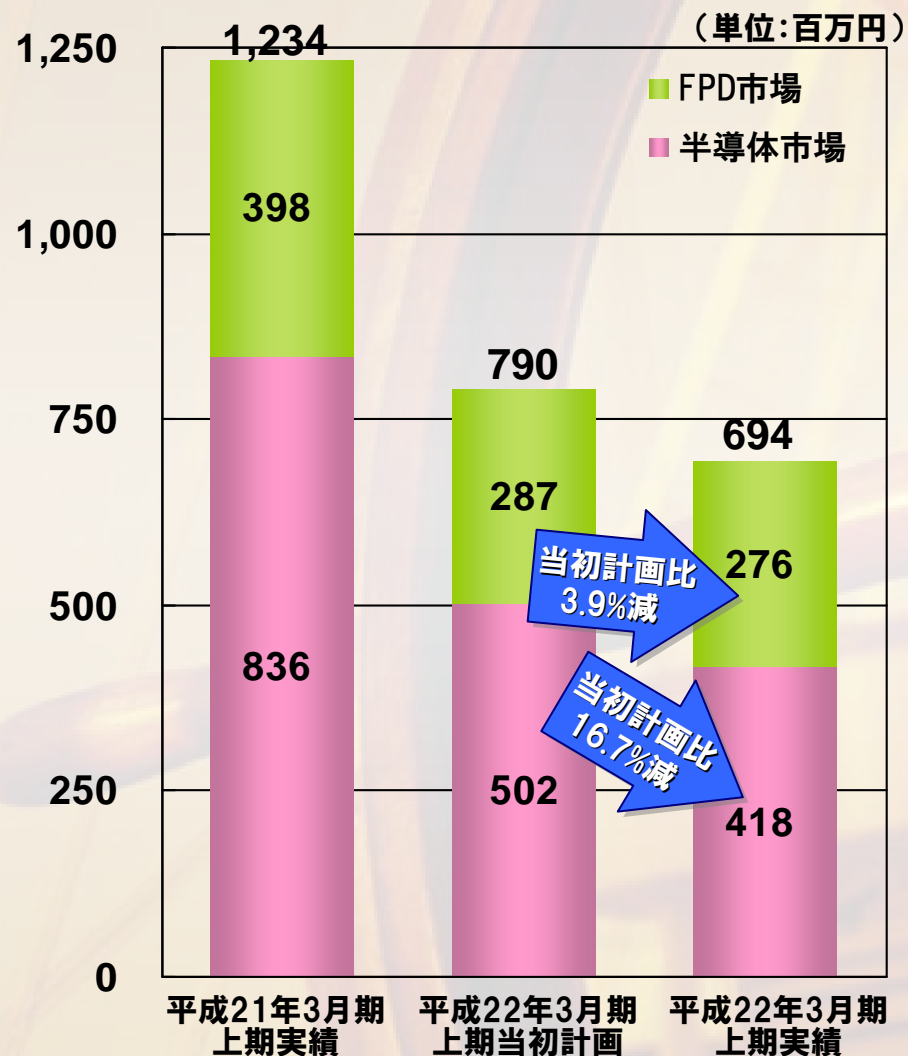


【通期比】



市場別売上高（半導体/FPD） -対計画比-

【半期比】

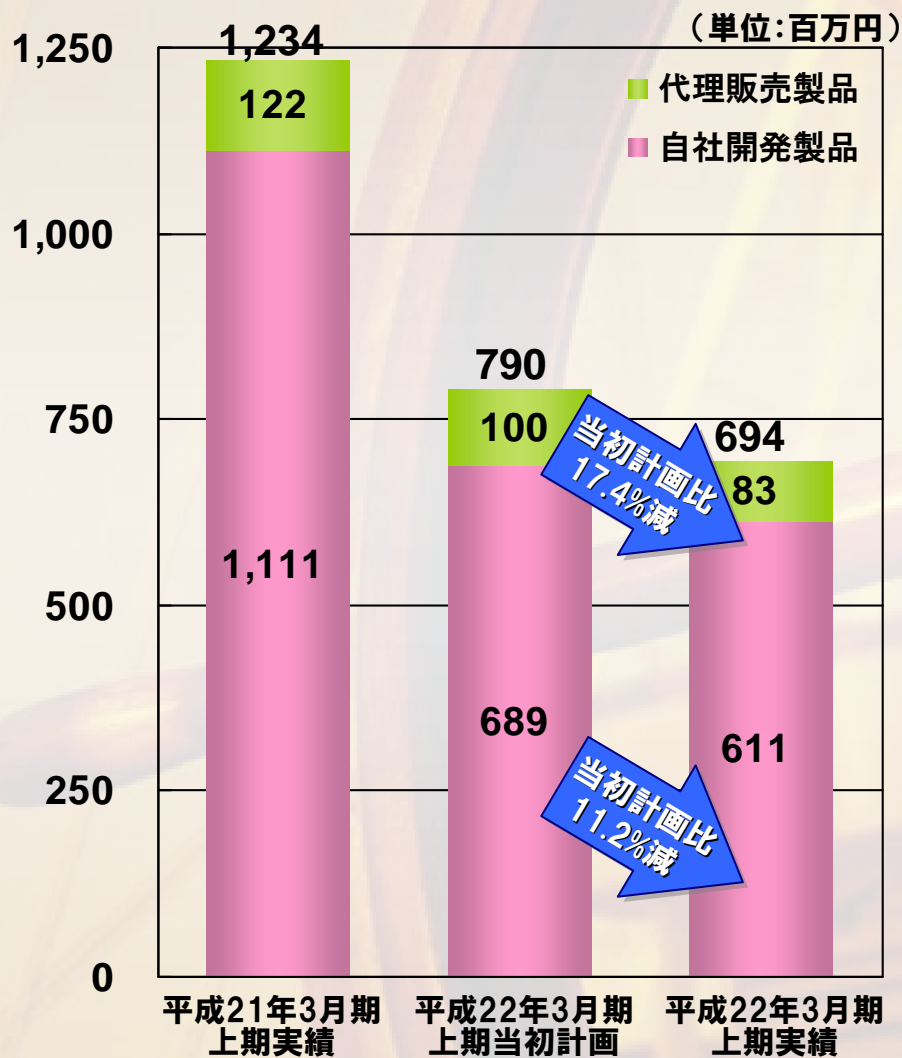


【通期比】

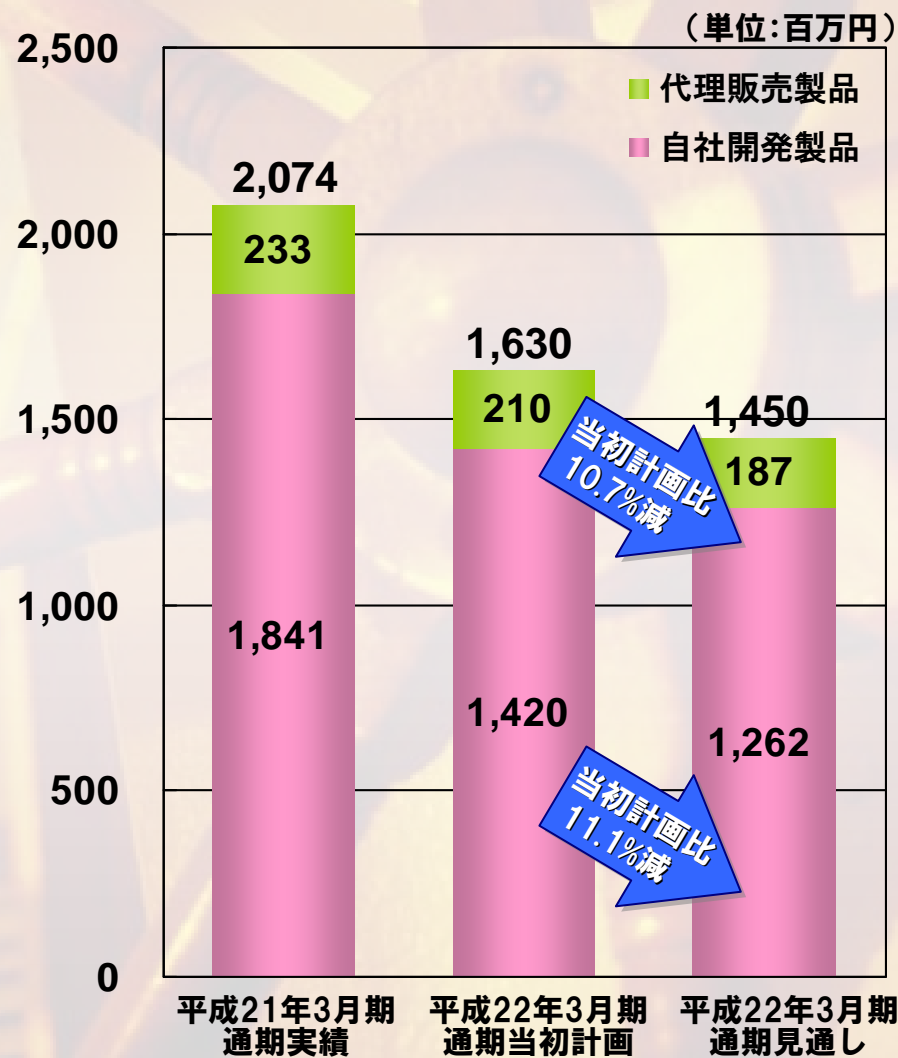


製品区分別売上高（自社開発／代理販売） -対計画比-

【半期比】



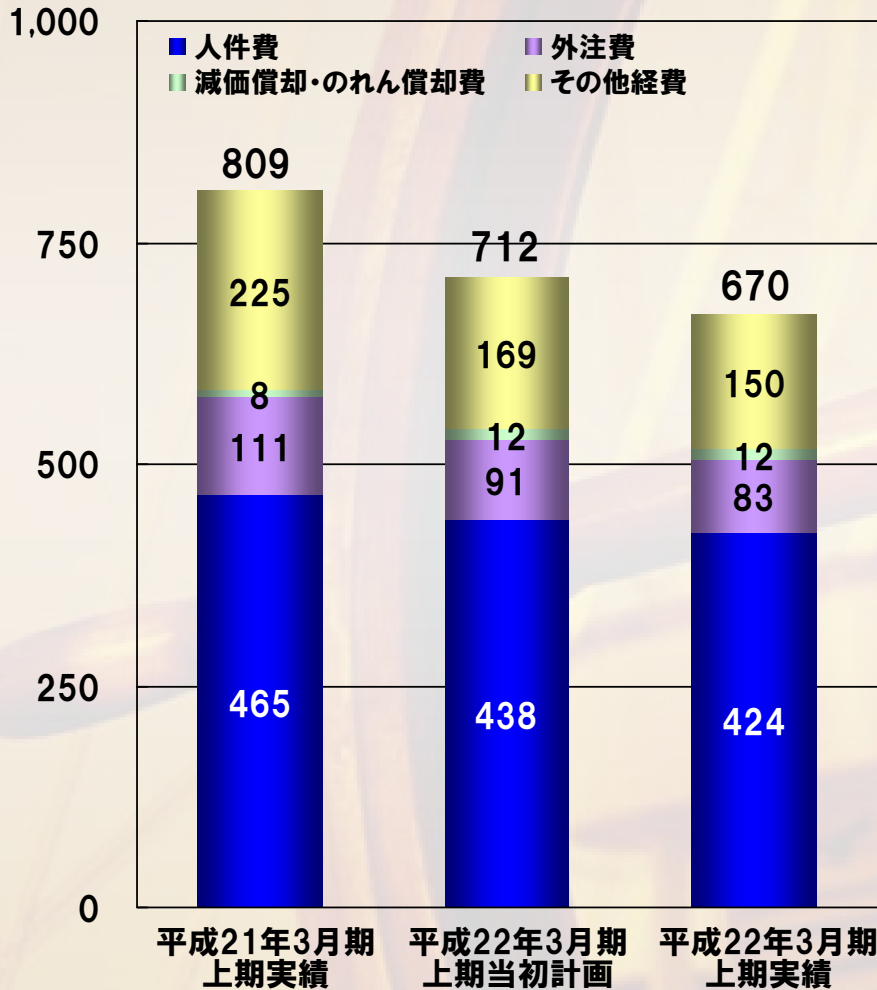
【通期比】



固定費内訳 -対計画比-

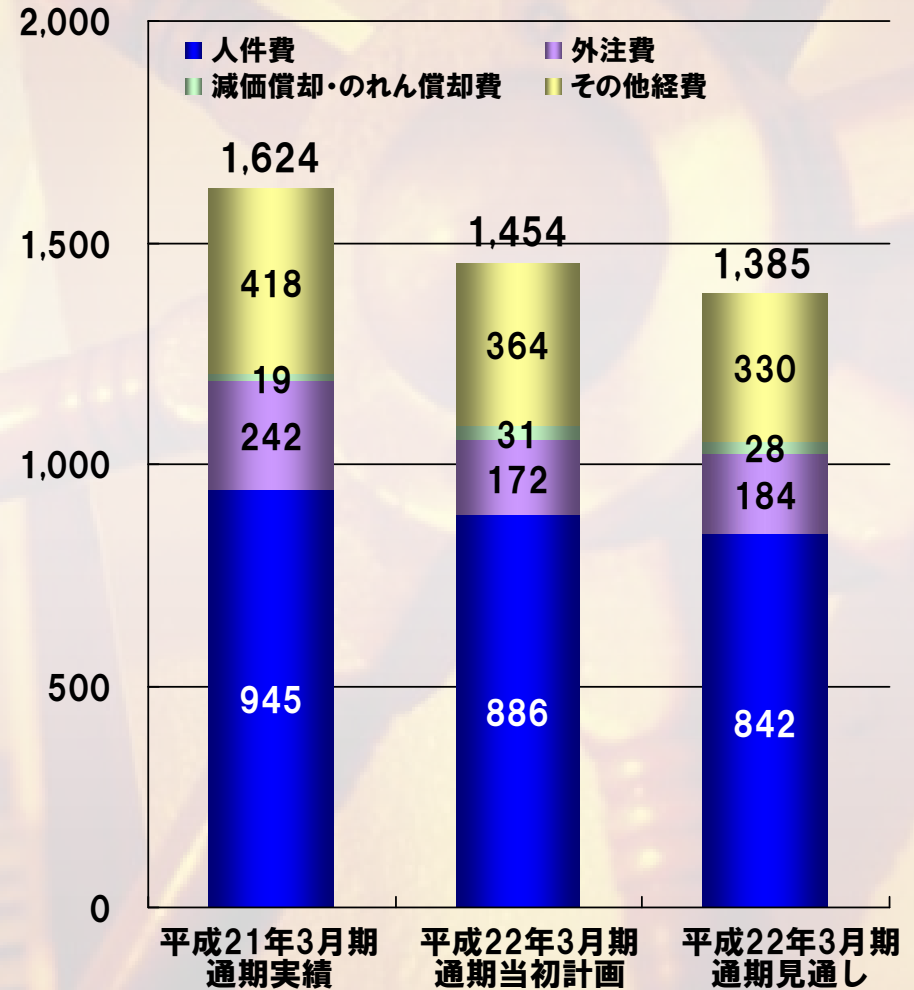
【半期比】

(単位:百万円)



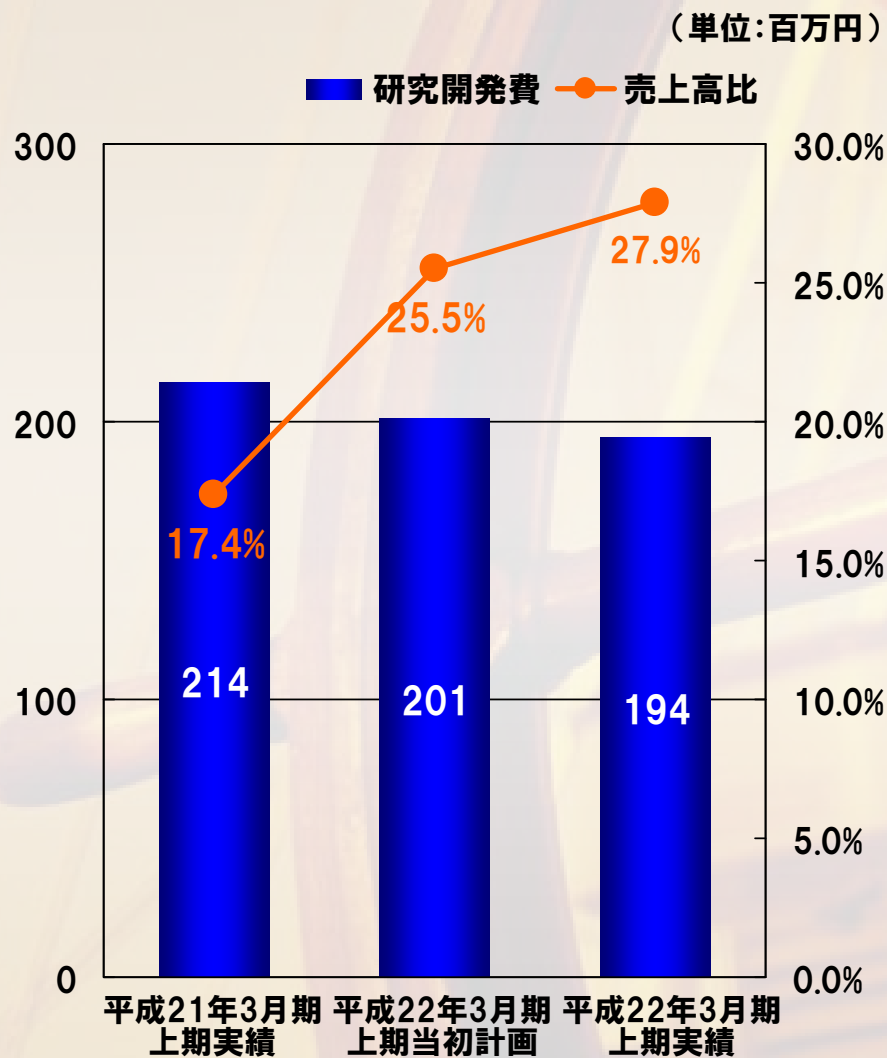
【通期比】

(単位:百万円)

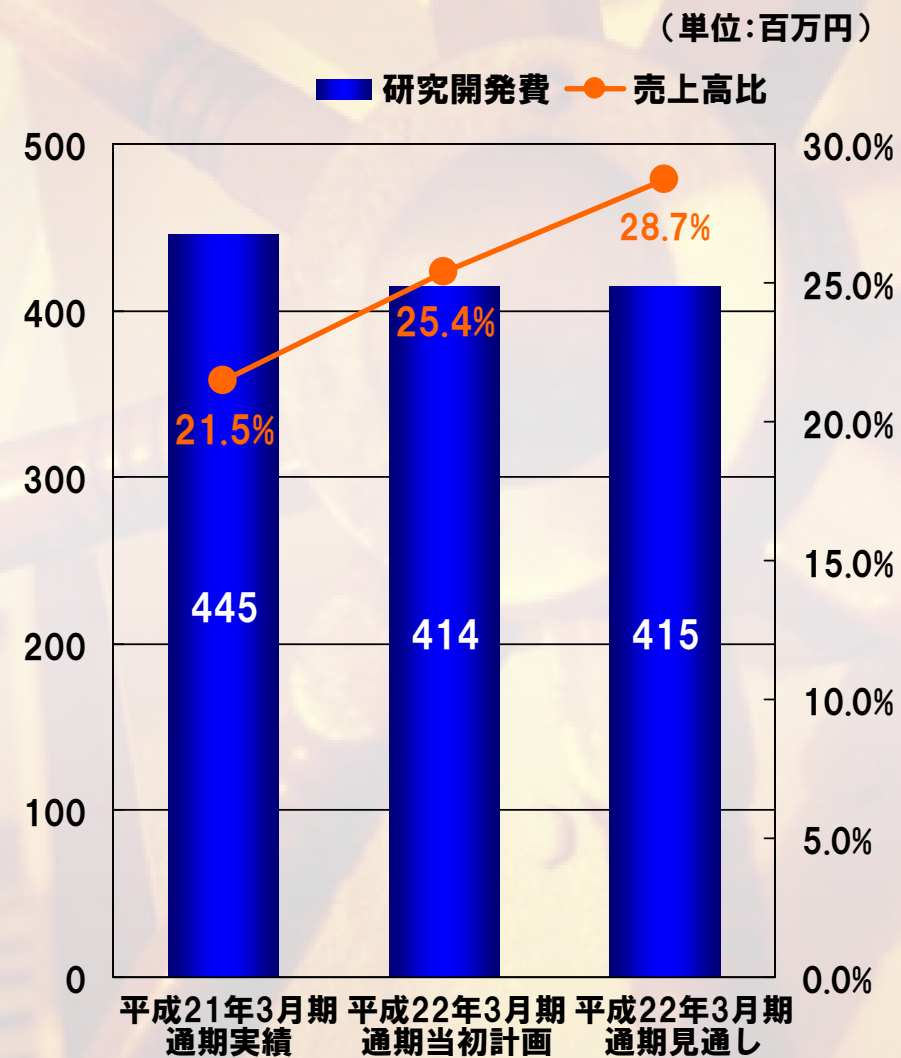


研究開発費 -対計画比-

【半期比】



【通期比】



主なトピックス（新製品関係）

- **液晶パネル設計における回路・光協調シミュレーション環境発表（7月）**
 - Jedat、Legend、Daouxiliconの3社提携
- **液晶ドライバIC／液晶パネルの拡張シミュレーション環境発表（7月）**
 - 最先端のパネル向けにパネル・ドライバ協調シミュレーションの提案
- **FPD向け高精度容量抽出：FineQap販売開始（10月）**
 - FPDパネル向けに対応した世界で唯一のツール
- **有機EL向け高精度電圧降下分布算出：FineVolt販売開始（10月）**
 - FPDパネル向けに対応した世界で唯一のツール
- **回路シミュレーション波形高速表示ツール：SpiceChart販売開始（10月）**
 - 大規模波形データの高速表示
- **統合回路設計ツール：C³ (Circuit-Cube) 販売開始（10月）**
 - シミュレーション効率大幅向上、ノウハウの継承、レイアウト品質向上

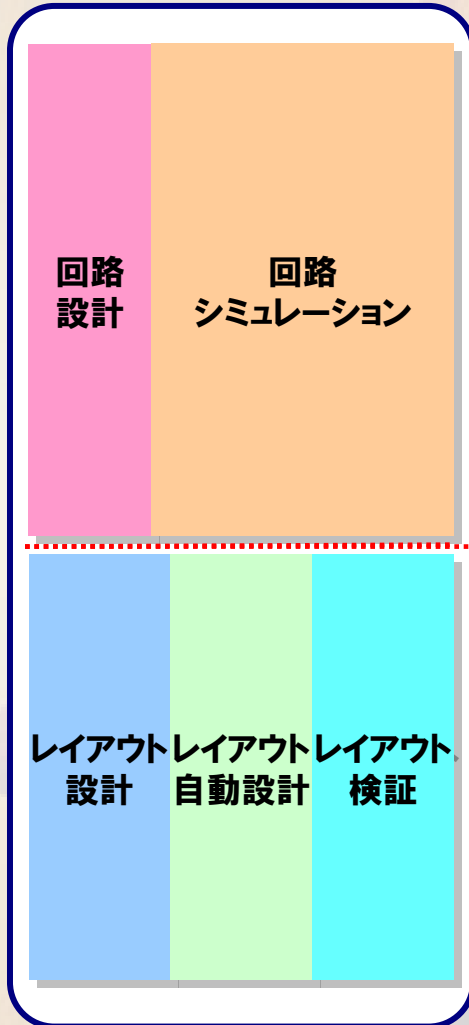
主なトピックス（イベント等）

- Model DiagnoserがTSMC社に正式採用（6月）
 - スタンダードセル検証ツール
- 主力製品：α-SX V3.5.0のリリース（8月）
 - FPD向け製品の拡充およびグローバル化の促進
- 顧客サービス強化のため本社移転（8月）
 - 共同立上げサービスに向けたプロジェクトルームを新設
- Mentor社と提携（8月）
 - Mentor社上流系製品との接続に関する提携
- プライベートショウを開催（10月）
 - 各種新製品を発表
 - 新設計移行時の障害要因とその解決事例を紹介



売上拡大に向けた施策の着実な実施1

半導体



現在、売上比の小さい(2%)回路設計分野での新製品開発を加速し2年後には比率を10%に高める

シミュレーション精度&効率UP

- C3 (Circuit-Cube) リリース
 - ・回路検証効率大幅向上
 - ・回路検証ノウハウの継承
 - ・レイアウト品質の向上
 - ・レイアウト設計との手戻り削減

競争力のあるレイアウト設計分野で売上拡大

→ 自動設計を取り入れた新設計手法の提案強化

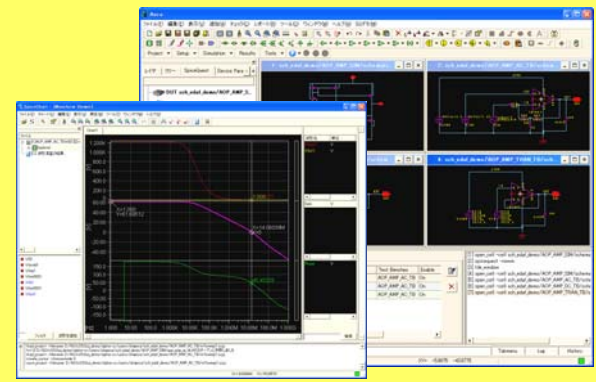
新設計手法の普及

- ベンチマーク事例による提案
 - ・プライベートフェアでの発表
 - 記事掲載
 - ・共同プロジェクト室を用意

戦略的新製品：C³ (Circuit-Cube)

回路設計

C³ (Circuit-Cube) 統合回路設計ツール

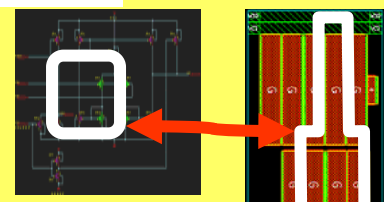


回路の検証シナリオ(手順/方法)や制約情報をデータベース化することにより、ノウハウを蓄積し再利用を行うことができる

回路設計に必要な機能を一体化することにより、効率良く設計・検証を進めることができる

回路制約情報からレイアウト制約情報を自動生成することにより、トータルの工数短縮と品質向上を実現できる

レイアウト設計



- *自動配置、配線
- *制約ドリブン編集

従来から、ジエダットが競争力を持つ分野

日経BP社TechOn! EDAサイトに紹介記事の掲載

「ユーザーの誤解を解きたい」、ジーダットがカスタムICのレイアウト設計用EDAのベンチマーク結果を発表
(2009/10/26)

最新カスタムレイアウト設計環境への大きな誤解

JEDAT EDA Fair 2009

求められる条件		主な誤解
チップ面積の追求		<ul style="list-style-type: none"> ・サイズが小さくならない ・回路階層通りにしかレイアウトできない
TAT短縮	品質	<ul style="list-style-type: none"> ・ネットリストがないと使えない ・編集の自由度が少ない ・編集速度が遅い
	効率化	<ul style="list-style-type: none"> ・既存資産が再利用できない ・本当に品質が上がるのか? ・自動の結果が良くない
コンカレント設計への確実な対応		<ul style="list-style-type: none"> ・デザインルール・回路変更への対応ができない
新環境の早期立上げ		<ul style="list-style-type: none"> ・準備に時間がかかる ・環境構築要員が必要

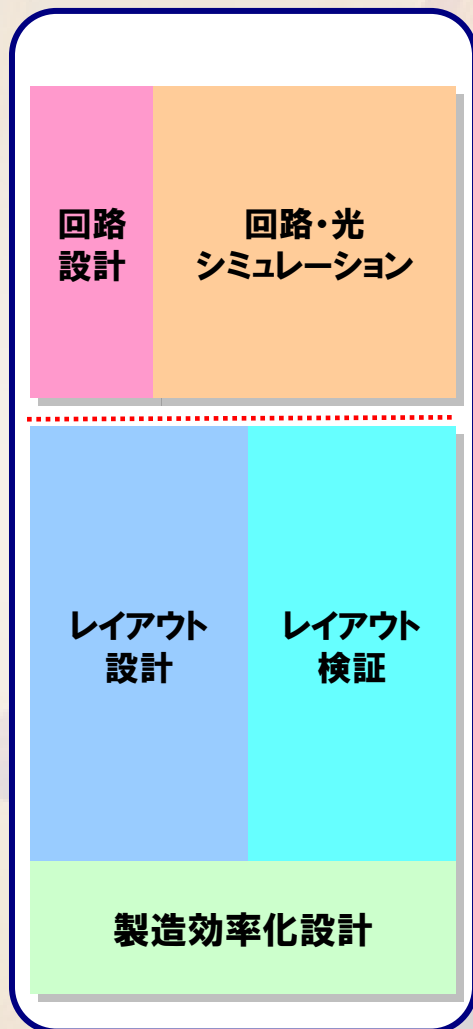
効果の一例

JEDAT EDA Fair 2009

定義: 1日/10h 素子数: 1200	既存環境 (ポリゴン設計手法)	α-SX 使用 (最新のレイアウト設計環境)
素子数/1日	30	120
面積見積りと トップフロアプラン	3日	2h
ブロック内レイアウト	1200/30 = 40日	1200/120 = 10日 (検証込み)
ブロック間配線	5日	3h
トップ検証	3日	0.5日
Total	51日	11日

売上拡大に向けた施策の着実な実施2

FPD

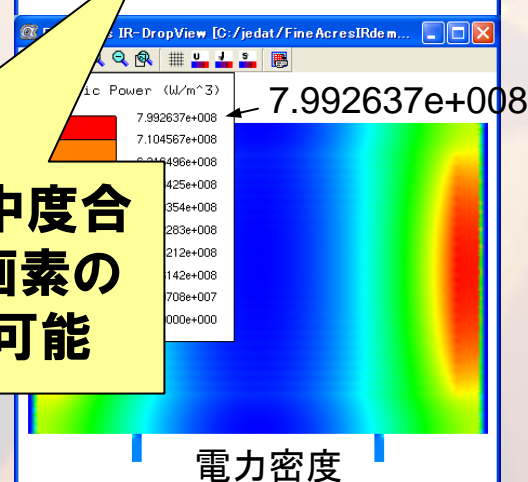
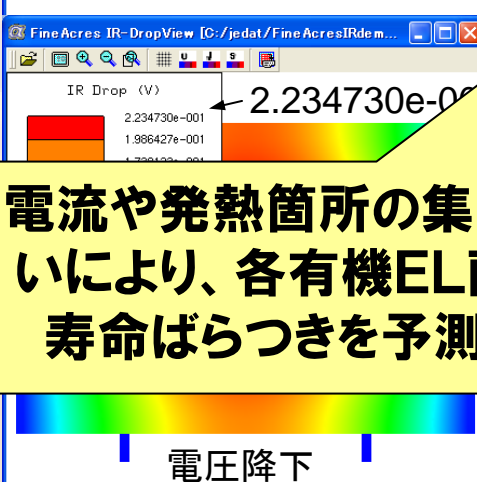
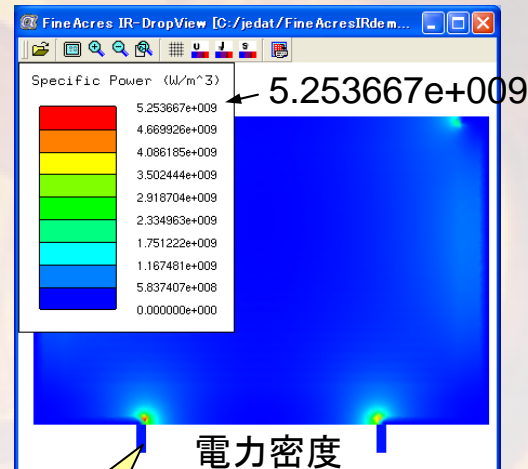
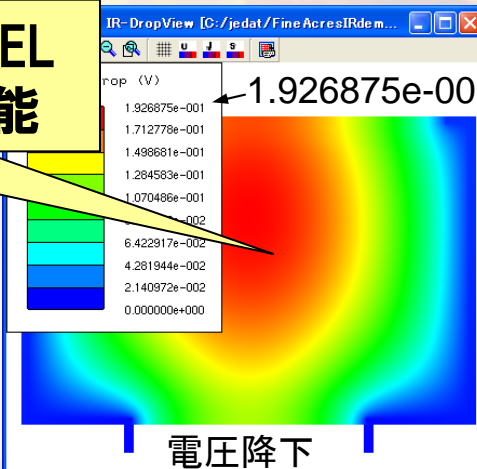
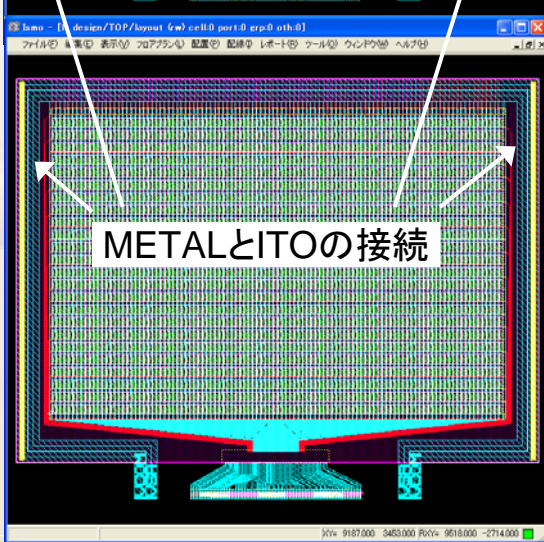
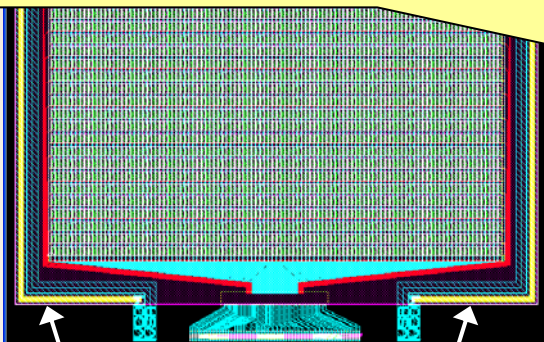


強みを活かした総取り戦略

- **FPD向け回路・光協調シミュレーション環境リリース**
 - ・光の動作を確認しながら回路検証を実施可
 - ・世界初
- **FPD向け高精度容量抽出: FineQapリリース**
 - ・従来の半導体向け容量抽出ツールでは誤差大
 - ・高速高精度3次元抽出
 - ・FPD向けとして世界初
- **有機EL向け電圧降下分布算出: FineVoltリリース**
 - ・有機ELパネルの画素間寿命ばらつきの均一化
 - ・高速高精度
 - ・有機EL向けとして世界初

有機EL向け電圧降下算出:FineVolt

電圧降下の様子から有機ELの表示ばらつきを予測可能



電流や発熱箇所の集中度合いにより、各有機EL画素の寿命ばらつきを予測可能

売上拡大に向けた施策の着実な実施3

現在の海外販売比率5%を3年後には20%に上げる

中国FPD市場拡大へ

の対応(α-SX)

- サポート体制の強化と販売代理店支援強化
- 北京R&D子会社→事業拠点
- 上海にサポート拠点

韓国FPD市場、台湾FPD市場の

拡販(α-SX)

- 販売代理店の支援強化
- 他社では出来ないこと(高精度高速抵抗・容量計算)から入る



実施済

今後、成果につなげていく

売上拡大に向けた施策の着実な実施4

韓国半導体市場の拡販(α-SX)

- アナログLSI, メモリ、ドライバーをターゲット
- 自動設計を取り入れた新設計手法の提案
- 販売代理店の支援強化



実施中

**上流(回路)設計
ツールの充実により、
今後加速**

HOTSCOPEの拡販

- 世界中の半導体市場をターゲット
- 販売代理店の増強



実施中

米国・欧州半導体市場の拡販(α-SX)

- アナログLSIをターゲット
- 自社AEを置く



未着手

本年は様子見



ご清聴ありがとうございました